

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260423

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	华安基金：桑翔宇、于嘉轩、刘潇、王斌、吴秋一，国盛证券：陈威威，南土资产：王可，理成资产：王元廷等，共 8 名证券人员
时间	2026 年 4 月 22 日下午 14:00~16:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026 年 4 月 22 日下午 14:00~16:30：董事会秘书杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p style="text-align: center;"><b>公司介绍：</b></p> <p>公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p style="text-align: center;"><b>问 1：公司潜江年产 300 吨 KrF/ArF 高端光刻胶项目顺利投产后，在产线自研壁垒与原材料自主化方面，相较于行业同业具备哪些差异化优势？</b></p> <p><b>答：</b>公司潜江 300 吨高端晶圆光刻胶项目为国内首条有机合成-高分子合成-精制纯化-混配封装全流程自主量产线，具体来看主要有三大核心优势：一是实现主体树脂、高纯单体、光酸剂等光刻胶核心原材料全链条自研自产，从源头实现了上游关键材料自主制备，有效降低了供应链波动风险，保障了产品供应的稳定性和安全性，同时也显著提升了产品的成本控制能力；二是产线采用高度自动化、智能化的生产设备与管控系统，搭载专属的产品验证适配体系，可灵活覆盖逻辑芯片、存储芯片等不同类型晶圆的全制程节点，适配下游客户的多样化需求；三是经过多年的技术沉淀与工程化打磨，公司在光刻胶生产的关键环节形成了成熟的技术积累，金属离子管控、纯度管控</p>

等核心指标已对标国际一流水平，为后续产品快速通过客户验证、实现规模化放量筑牢了底层技术壁垒，是公司在高端半导体材料领域的核心增长支点，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。

**问 2：目前公司 CMP 材料已实现抛光垫、抛光液、清洗液全覆盖布局，后续配套产能扩建项目的推进节奏与产业链完善规划如何？**

**答：**公司始终坚持以市场需求为导向，持续完善 CMP 全产业链布局，后续配套产能扩建与产业链完善将按既定规划稳步推进：在现有产能方面，武汉本部的 CMP 抛光硬垫产线、潜江园区的抛光软垫及缓冲垫产线正有序爬坡，产能释放进度符合预期，可充分满足当前下游客户的订单需求；仙桃万吨级 CMP 抛光液产线保持高效稳定运行，为抛光液产品的规模化放量提供了坚实保障。在新增产能与产业链完善方面，公司光电半导体材料研发制造中心项目正稳步推进建设，该项目规划了大硅片用抛光垫、预聚体、微球材料等配套产能，建成后将进一步补齐公司 CMP 材料上游核心原材料的配套环节，实现从原材料到终端产品的全链条自主制备，有效降低生产成本、提升供应链稳定性。同时，公司将持续跟进下游晶圆厂的扩产节奏，动态调整产能规划，确保产能供给与市场需求精准匹配，进一步巩固公司在全球 CMP 材料领域的综合布局优势。

**问 3：在全球半导体增长背景下，公司核心半导体材料的上游供应链保障体系有何布局优势？**

**答：**面对全球半导体供应链波动、国际贸易环境复杂多变的外部形势，公司长期坚持核心原材料自主制备的战略布局，已构建起稳定、安全、自主的供应链保障体系，核心优势主要体现在两个方面：一方面，公司已完成核心原材料的全链条自研自产布局，无论是高端晶圆光刻胶的核心树脂、功能单体、光酸剂，还是 CMP 材料核心的微球、研磨粒子等关键原料，均已实现自主研发、自主生产，大幅降低了外部供应链波动、国际贸易壁垒带来的供应风险，从源头保障了产品生产的连续性；另一方面，公司采用多基地分散化产能布局模式，在武汉、潜江、仙桃等地布局了多个生产基地，可有效规避单一基地生产可能面临的各类风险，确保下游客户订单的及时交付。同时，公司持续优化供应链管理体系，与上游核心供应商建立长期稳定的合作关系，形成了“自主生产+多元备份”的双重保障机制，充分契合中国半导体产业链自主研发和制备的发展趋势，为公司业务的持续稳定发展提供了坚实支撑。

**问 4：公司长期高额研发投入主要聚焦哪些技术方向，研发体系如何支撑多品类材料持续突破？**

**答：**公司始终高度重视研发投入，将技术创新作为核心发展战略，长期保持高额研发投入，研发方向严格围绕半导体前道核心耗材国产替代展开，重点聚焦高端晶圆光刻胶、全系列 CMP 材料、先进封装材料、OLED 显示材料等关键领域，精准攻坚国内半导体产业的材料难题。在研发体系建设方面，公司构建了“基础研究-中试放大-量产落地”一体化的研发平台，形成了从技术研发到产业化落地的完整闭环，有效提升了研发成果的转化效率；同时，公司拥有一支专业化、高素质的技术研发团队，涵盖材料合成、工艺

	<p>优化、产品验证等多个领域，积累了庞大的专利储备，形成了难以复制的技术护城河。此外，公司通过与国内高校、科研院所建立产学研合作关系，整合行业优质研发资源，持续提升技术研发实力，形成了技术迭代、新品研发、工艺优化的良性循环，为公司多品类电子材料实现持续突破、巩固行业领先地位提供了强有力的核心支撑。</p> <p><b>问 5：相较于行业内单一赛道材料企业，公司多材料平台化布局的长期经营优势体现在哪些方面？</b></p> <p><b>答：</b>公司作为国内少有的横跨半导体晶圆光刻胶、CMP 全系列抛光材料、柔性显示材料的平台型电子材料平台企业，相较于行业内单一赛道材料企业，具备显著的长期经营优势，主要体现在四个方面：一是客户资源互通共享优势，公司同一晶圆厂、面板厂客户可同步导入多品类产品，不仅能够提升客户合作深度和粘性，还能降低开发、导入成本，实现客户价值最大化；二是技术底层同源优势，公司在精细化工合成、高纯纯化、材料改性等核心技术领域积累深厚，相关技术可跨高端晶圆光刻胶、CMP 材料、显示材料等多个品类复用，有效提升研发效率；三是资源共享降本增效优势，公司的产能、供应链、研发平台可实现多业务板块共享，优化资源配置，降低整体运营成本，提升企业综合盈利能力；四是抗周期风险优势，多赛道业务布局能够有效对冲单一行业周期波动带来的经营风险，确保公司整体经营的稳定性和持续性，为公司长期战略落地提供坚实保障，同时也为公司拓展更广阔的成长空间奠定了基础。</p> <p><b>问 6：结合当前产能落地与业务整合进度，公司如何保障 2026 年度全年业绩目标稳步达成？</b></p> <p><b>答：</b>公司 2026 年度经营目标明确，结合当前产能落地与业务整合进度，将从多维度保障全年业绩目标稳步达成：一是核心半导体材料业务全面发力，CMP 抛光材料领域涵盖抛光垫、抛光液等全系列产品，目前与国内主流晶圆厂合作持续深化，潜江、仙桃产能稳步释放，同时海外市场有序拓展；光刻胶业务方面，潜江 300 吨产线投产，涵盖高端晶圆光刻胶等产品，多款产品已完成客户验证并实现批量供货。显示材料板块，公司柔性 OLED 显示材料产品持续迭代，依托现有客户资源稳步放量，巩固国产供应优势。二是子公司皓飞新材并表后，其锂电功能性辅材产品与公司现有业务形成协同，通过供应链内部配套与资源共享，贡献稳定业绩增量。三是完成通用打印耗材终端业务剥离后，资源聚焦于半导体、新能源等核心材料业务，精简管理架构、提升运营效率，推动盈利质量提升。四是持续加大核心领域研发投入，巩固技术与成本壁垒，同时强化内部精细化管理、严控经营成本，确保各项经营计划高效落地。综上，依托核心业务增长、子公司协同、结构优化、研发支撑及精细化管理，公司将切实保障 2026 年度全年业绩目标有序达成。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 4 月 22 日